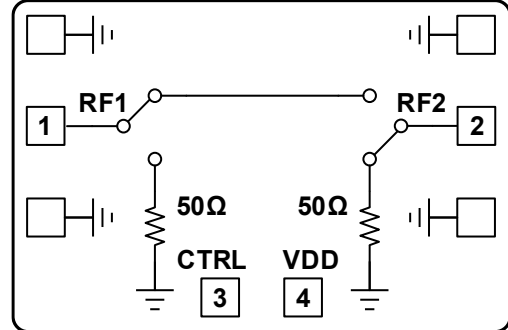




主要特点

- 全正压控制
- 隔离度: 47 dB @ 20 GHz
- 插入损耗: 1.9 dB @ 20 GHz
- 匹配式设计
- 供电: +5 V @ 1 mA
- 芯片尺寸: 1.5 × 0.8 × 0.1 mm³

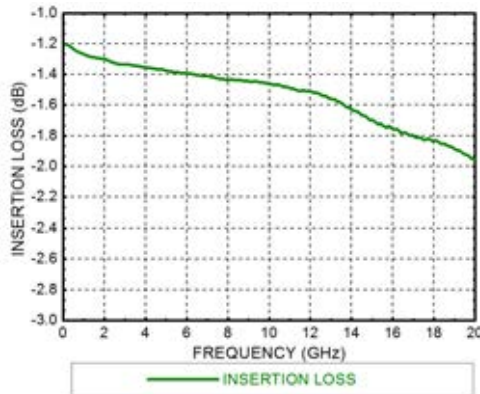
功能框图



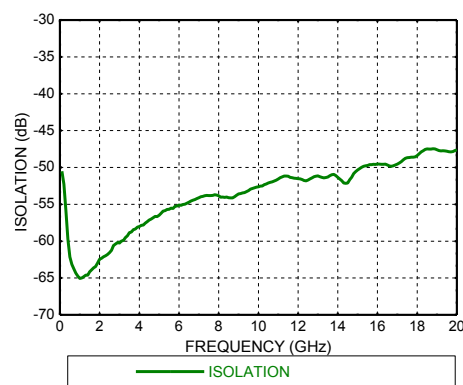
性能指标 ($T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $CTRL = 0/+3.3\text{V}$, $VDD = +5\text{V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	0.1 - 20			GHz
插入损耗		1.6		dB
隔离度		50		dB
回波损耗“打开状态”		20		dB
回波损耗“关闭状态”		20		dB
输入功率 1dB 压缩点 @1-20GHz		22		dBm
开关切换时间		30		ns

插入损耗

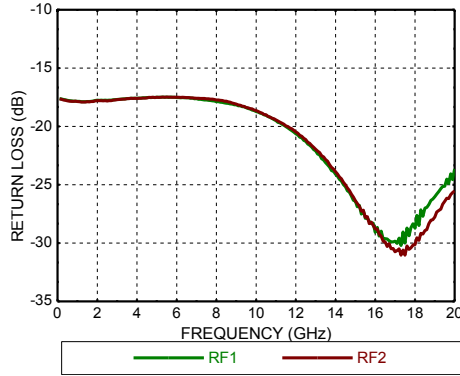


隔离度

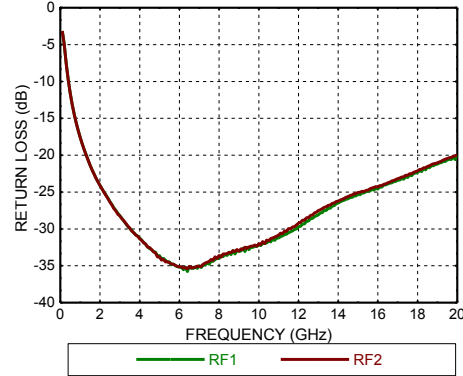




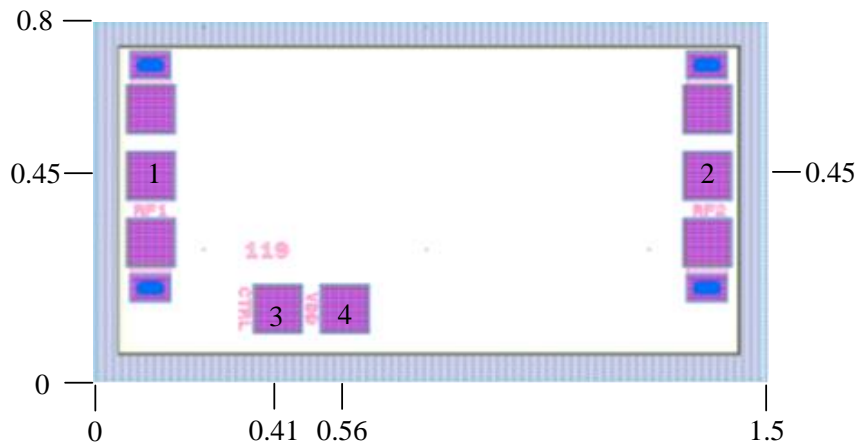
回波损耗, "ON" 状态



回波损耗, "OFF" 状态



物理参数



焊盘描述

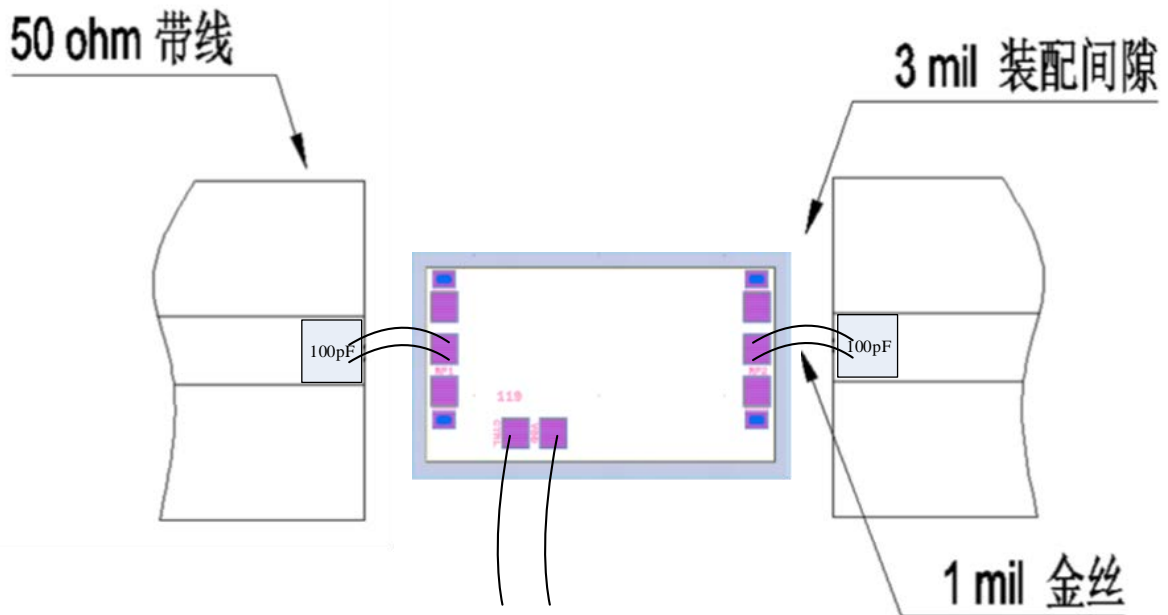
焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频输入输出端口, 需要外部加入隔直电容
3	CTRL	CTRL=5V 则 RF1、RF2 为 "ON" 状态; CTRL=0V, 则为 "OFF" 状态
4	VDD	该焊盘为数字电路电源端, 接+5V 电源电压
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

功能	CTRL
ON	1
OFF	0
“0”电平范围：0~0.8V，“1”电平范围：2.3~5V。	

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100 μm^2
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率：+30 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +175 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$